**证券代码：688535 证券简称：华海诚科**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 海通证券、华安证券等 |
| **会议时间** | 2024年 11月 25日10：00-11：00 |
| **会议地点** | 线上 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理：韩江龙  董事会秘书：董东峰  证券事务代表：钱云  证券事务专员：张雅婷 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 问题一：请问贵司在汽车电子行业领域和光伏领域的业务发展情况？  回复：用于汽车电子的高导热高可靠性产品已经完成客户考核认证，处于量产前期；公司已经完成对光伏用塑封料深度开发，且按照客户的需求，完成对原来产品的迭代。  问题二：请问当下公司高端环氧塑封料产品能够实现国产化替代吗？  回复：高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间，现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位，即便有部分高端塑封料实现了量产出货，但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。  问题三：公司整体的业务进展如何？  回复：公司立足于传统封装领域逐步扩大市场份额，并积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。在传统封装领域，公司应用于SOT、SOP领域的产品的市场份额逐步提升。在先进封装领域，公司应用于QFN的产品700系列产品已实现小批量生产与销售；同时，公司紧跟先进封装未来发展趋势，布局晶圆级封装与系统级封装，在上述领域的产品布局逐步完善，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证，有望逐步实现产业化。  问题四：请问公司是否有材料可以应用于HBM存储产业链？  回复：公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。  问题五：请问贵司GMC发展情况？  回复：在先进封装领域，GMC 产品已经在多个客户考核通过，自主研发的GMC 制造专用设备已经具备量产能力并持续优化。  问题六：请问可以介绍一下公司产品有何科技含量吗？  回复：公司属于半导体封装材料行业，是典型的技术密集型行业。该行业终端应用广泛而复杂，环氧塑封料、芯片级电子胶黏剂等是保证芯片功能稳定实现的关键材料，需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求针对性地调整配方及生产工艺；产品研发还涉及高分子材料、有机化学、有机合成、无机非金属材料等多门学科的交叉，因此技术门槛较高。  问题七：请问LMC和GMC有什么区别？  回复：LMC是指液态塑封材料，LMC 是通过将液态树脂挤压到产品中央，在塑封机温度和压力的作用下增强液态树脂的流动性，从而填充满整个晶圆。LMC 具备可中低温固化、低翘曲、模塑过程无粉尘、低吸水率以及高可靠性等优点，是目前应用于晶圆级封装的相对成熟的塑封材料；GMC是指颗粒状环氧塑封材料，颗粒状环氧塑封料在塑封过程采用均匀撒粉的方式，在预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入到树脂中而成型，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势。  **注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。** |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年11月 25日 |